



Гусев В. В., Самоуликов В. К.
Физические основы проектирования оборудования

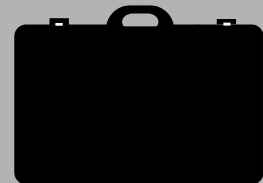
Настоящее пособие написано на основе курса лекций, прочитанных для студентов 3-го курса факультета автоматики и электронного машиностроения (АЭМ) МИЭТ. В сжатой форме изложены аспекты прикладной физики, необходимые для понимания принципов работы и выполнения расчетов элементов современного технологического оборудования и электрофизического оборудования бытового назначения. Рассмотрены основополагающие законы и закономерности для физико-термических и плазмохимических технологических процессов, приведены расчетные зависимости, используемые для оценки конструктивно-технологических параметров оборудования. Каждая глава и большинство параграфов снабжены блоками вопросов для самоконтроля, которые должны помочь обучающимся усвоить и закрепить учебный материал.

Для студентов инженерно-конструкторских специальностей вузов.



Дополнительная информация по тел. (095) 532-9832, e-mail: ipk@md.miee.ru

в портфеле редакции



в портфеле редакции

в портфеле редакции

- Об оценке эффективности АТМ-коммутаторов методом имитационного моделирования. *Ю. А. Семшин, Ю. Г. Майба, О. В. Литвинова (Украина, г. Одесса)*
- Техника и технология полимерных сферических микролинз для волоконно-оптических систем. *Я. В. Бобицкий, А. П. Лаба (Украина, г. Львов)*

в портфеле редакции

в портфеле редакции

в портфеле редакции

в портфеле редакции

в портфеле редакции

в портфеле редакции



**Издательско-полиграфический комплекс
Московского государственного института электронной техники**

НОВЫЕ КНИГИ



**Сорокин И. Н., Акуленок М. В.
Технология электронных средств**

Описана технология электронных компонентов, в частности, базовые процессы технологии микроэлектроники. В основу положен курс лекций для студентов МИЭТ, обучающихся по специальности «Материалы и компоненты электроники».

Учебное пособие включает 6 глав, в каждой из которых представлен один из основных технологических процессов формирования твердотельных компонентов электронной техники и дано современное представление о механизме процесса, его технологических особенностях и способах реализации.

Рассмотрены следующие процессы: автоэпитаксия кремния, формирование диэлектрических пленок методами термического окисления и осаждения, процессы формирования проводящих систем, травления, в том числе жидкостного химического, травления в парогазовых смесях и "сухого" травления, легирования полупроводниковых структур методами термодиффузии, диффузии из легированных пленок оксидов или поликристаллического кремния, ионной имплантации, а также процессы литографии.

Для студентов, обучающихся по специальностям 200.100 и 200.200.

Дополнительная информация по тел. (095) 532-9832, e-mail: ipk@rnd.miee.ru